



TG-A09AB / TG-S09AB 導熱封膠 Silicone Potting Compound

REACH Compliant RoHS Compliant

產品特性 Features

- 優異導熱性能
Good thermal conductivity
- 固化後保護電子元件防止受外界環境影響
Protect electronic components after cured
- 一比一比例混合
A:B=1:1
- 室溫或加熱熟化
Cured by room temperature or heating

產品應用端 Application:

電子元件 Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

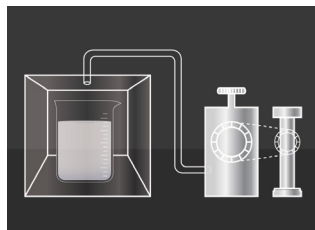
保存方式 Storage:

導熱封膠其在未開封之狀態，在室溫 25°C 以下可保存 12 個月。
Silicone Potting Compound has a shelf-life of 12 months from the date of manufacture, as indicated by the lot number, when stored in the original, should be unopened container at or below 25°C.

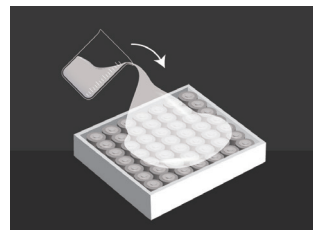
操作說明 Operation Manual



① Mix component A and B.



② Vacuum out air.

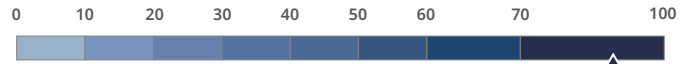
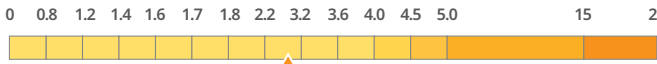


③ Pour potting compound.

產品物性 Properties

導熱係數 Thermal Conductivity : 2.8 W/m•K

硬度 Hardness : 90 (Shore OO)



Properties	Unit	TG-A09AB / TG-S09AB	Tolerance	Test Method
導熱係數 Thermal Conductivity	W/m•K	2.8	±10%	ASTM D5470 Modified
顏色 Color	-	灰 Gray (混合 Mix)	-	-
耐電壓 Dielectric Breakdown Voltage	KV/mm	≥11	-	ASTM D149
體積阻抗 Volume Resistivity	Ohm-m	≥10 ¹²	-	ASTMD257
密度 Density	g/cm ³	2.52	±5%	ASTM D792
操作溫度 Operating temperature	°C	-50~+150	-	-
抗拉強度 Tensile Strength @3.0mm	kgf/cm ²	230	-	ASTM D412
延展率 Elongation	%	55	-	ASTM D412
黏度 Viscosity	Pa•s	10~50	-	Brookfield
重量損失 Weight Loss	%	<1	-	ASTM E595 Modified
固化時間 Curing Time @25° C	Hrs	6	±10%	-
固化時間 Curing Time @50° C	Hrs	0.6	±10%	-
固化時間 Curing Time @80° C	Hrs	0.08	±10%	-
標準規格 Standard Package	-	罐裝 Pot	-	-
硬度 Hardness	Shore OO	90	±10	-
混合比例 Mixing Ratio	gram	1:1	-	-

▶ A 劑與 B 劑皆為混合材料，因密度不同會造成沉澱分層，屬正常現象，使用前請用扁平刮刀或是其他不鏽鋼工具，分別均勻攪拌兩劑再混和，以獲得最好的導熱效果。
Component A & Component B are mixed material. It is normal to cause precipitation and stratification due to different density. Well mixed component A before use by a flat spatula or other stainless tools to achieve the ideal thermal conductivity.

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 號 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20240220



注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。

所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或 訂單，提供最標準的產品質量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造，與使用產品的建議。